

## 翰博高新材料（合肥）股份有限公司

### 关于公司为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

为保证子公司的正常生产经营活动，根据未来的融资和担保需求，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月29日召开第四届董事会第六次会议、2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2024年度担保额度事项的议案》，同意公司2024年为合并报表范围内子公司提供担保，新增总担保额度不超过人民币242,000万元，担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资性担保主要用于控股子公司在银行及其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、保理、押汇、外汇及金融衍生品等业务）提供担保，非融资性担保主要用于为控股子公司在对应债权人处购买产品提供担保等。其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过87,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过155,000万元。在累计不超过242,000万元总担保额度内，公司股东大会授权公司管理层可根据实际经营情况对公司对控股子公司的担保额度进行调配，资产负债率未超过70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。

在已经股东大会审批的担保额度不变前提下，将拟为全资子公司重庆博硕光电有限公司（以下简称“重庆博硕”）提供的部分担保额度调配至全资子公司重庆汇翔达电子有限公司（以下简称“重庆汇翔达”）。调整后，公司2024年可新增为重庆博硕提供的担保额度为68,500万元，公司可新增为重庆汇翔达提供的担保额度为2,500万元。

## 二、本次担保情况

根据业务发展需要，重庆汇翔达向中国银行股份有限公司重庆北培支行（以下简称“中国银行”）申请签订流动资金借款合同（以下简称“主合同”），借款金额为人民币壹仟万元整。公司与中国银行于2024年5月27日签署《保证合同》，同意为主合同项下债务提供连带责任保证，担保的债权包括主合同项下债权及利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

截至本公告披露日，公司实际为重庆汇翔达提供担保额度总额共计人民币2,500万元（实际使用额度1,000万元），上述担保额度在已审议通过的担保额度范围内。

## 三、被担保人基本情况

**公司名称：重庆汇翔达电子有限公司**

**成立日期：2019年1月10日**

**注册地址：重庆市北碚区水善路19号**

**法定代表人：肖志光**

**注册资本：500万元**

**经营范围：一般项目：五金交电、电子产品（不含电子出版物）及配件、电子设备及配件、模具、标准件、摄影器材、通讯设备（不含无线电地面接收设备及发射设备）、光电产品、机械设备及配件的加工、组装、销售；货物及技术的进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）**

**股权结构：公司持有其100%股权。**

**主要财务指标：**

单位：人民币元

主要财务指标	2024年3月31日/2024年1-3月 (未经审计)	2023年12月31日/2023年度 (经审计)
总资产	71,110,545.97	61,591,184.21
负债总额	44,043,013.70	34,207,558.73
净资产	27,067,532.27	27,383,625.48
资产负债率	61.94%	55.54%
营业收入	11,476,385.63	65,411,603.42
净利润	-316,093.21	4,151,451.96

注：上述数据为单体报表数据。

信用情况：被担保人不是失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

债权人：中国银行股份有限公司重庆北培支行

被担保方：重庆汇翔达电子有限公司

保证人：翰博高新材料（合肥）股份有限公司

担保金额：担保的债权包括主合同项下债权及利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

保证方式：连带责任保证；

保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期间届满之日起三年。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保情况如下：

被担保方	担保额 度	实际担保余 额	公告披露日 期	是否资产 负债率超 过 70%
	(万 元)	(万元)		
重庆博硕光电有限公司	19,000	11,327	2023/11/27	否
	12,000	5,100	2022/11/21	
	5,000	1,679	2023/11/7	
	6,000	5,484	2023/5/22	
	15,000	5,994	2023/12/19	
	5,000	2,365	2023/12/19	

小计	62,000	31,948	-	
博讯光电科技（合肥）有限公司	13,000	12,543	2024/4/18	是
	10,000	9,250	2022/1/27	
	35,000	17,361	2020/12/10	
	10,000	9,807	2024/2/23	
	7,000	2,531	2024/4/9	
	10,000	2,775	2023/11/27	
	10,000	6,201	2024/4/9	
	10,000	9,101	2023/8/29	
	7,000	3,688	2024/3/19	
	6,000	3,623	2023/11/7	
	7,800	3,899	2024/4/9	
小计	125,800	80,778	-	
合肥星宸新材料有限公司	2,000	1,975	2024/3/19	否
小计	2,000	1,975		
重庆汇翔达电子有限公司	1,000	1,000	本次新增	否
小计	1,000	1,000		
博晶科技（滁州）有限公司	150,000	78,320	2022/4/29	是
小计	150,000	78,320	-	
重庆翰博显示科技有限公司	4,000	1,182	2023/1/3	是
重庆翰博显示科技有限公司、重庆翰博显示科技研发中心有限公司（注）	27,500	27,500	2020/10/13	是
小计	31,500	28,682	-	-
<b>合计</b>	<b>372,300</b>	<b>222,703</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

注：重庆翰博显示科技有限公司与重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（简称“两江投资公司”）于2020年10月22日签署《翰博高新背光模组和研发中心项目代建协议》，重庆翰博显示科技有限公司委托两江投资公司建设翰博高新背光模组和研发中心项目，公司提供保证，保证期间到代建合同债务结束。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司已审议通过的累计可对外担保总额度为41.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的315.13%。本次提供担保后，公司及其控股子公司签署的担保合同处于有效期内的担保总额度为37.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为279.67%，实际担保余额为22.2703亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为167.30%。担保均系公司合并报表范围内公司之间提供的担保，不存在其他对合并报表范围外单位提供担保的情形。

截至本公告披露日，公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保

及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

## 六、备查文件

《保证合同》等。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2024年5月29日